

Lötspitze abgeschrägt 45° 0,7 mm Micro Fine Serie T - Thermaltronics TM70BV007

Artikel-Nr. WL38443

Hersteller Thermaltronics

Feine 45°-Schrägschmelzspitze mit nur 0,7 mm Spitzenbreite für Drag-Löten an Fine-Pitch-Bauteilen und einzelnen QFP-Beinchen. Die abgeschrägte Fläche nimmt eine kleine Lotmenge auf und gibt sie kontrolliert an die Lötstelle ab. T-Kartusche mit Curie-geregeltem Arbeitsbereich von 350-398 °C für die Handstücke SHP-T.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.1 kg
Positionserkennung	Nein



BESCHREIBUNG

Wenn eng benachbarte SMD-Anschlüsse in einem Zug verlötet werden sollen, braucht es eine Spitze, die Lot hält und gleichzeitig schmal genug für den Pitch bleibt. Die TM70BV007 ist eine um 45° angeschrägte Micro-Fine-Kartusche mit 0,7 mm Spitzenbreite und 16 mm Spitzenlänge aus der T-Serie von Thermaltronics.

VORTEILE

- Anschrägung von 45° mit kleiner Lotdepotfläche für sauberes Drag-Löten
- Spitzenbreite 0,7 mm (0,03 in) für Fine-Pitch-Anschlüsse und Micro-Fine-Arbeiten
- Spitzenlänge 16 mm für gute Sicht und Zugang zwischen hohen Bauteilen
- Curie-Punkt-Heiztechnik hält den Arbeitsbereich von 350-398 °C ohne Kalibrierung
- RoHS-konform und für bleifreie Lote ausgelegt

ANWENDUNGEN

Drag-Löten von QFP- und SOIC-Reihen, Nacharbeit an einzelnen Pins, Löten kleiner Chip-Bauteile und feiner Litzen in der Elektronikfertigung und im Reparaturlabor.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Passend für das Handstück SHP-T und die Lötstationen TMT-5000S-1 und TMT-5000S-2. Geliefert wird

eine einzelne Lötkartusche ohne Handstück und ohne Station.